

大连百傲化学股份有限公司

关于子公司拟对外投资暨增资并参股

芯慧联新（苏州）科技有限公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易事项概述

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司拟对外投资暨增资并参股芯慧联新（苏州）科技有限公司的议案》，公司基于半导体业务战略规划及发展需要，拟以全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称“芯傲华”）作为增资主体，与芯慧联新（苏州）科技有限公司（以下简称“芯慧联新”或“标的公司”）、芯慧联新实际控制人刘红军、芯慧联新现有股东及本轮其他投资人、芯慧联新员工持股平台上海芯鸿达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯慧联新员工持股平台”）签署《关于芯慧联新（苏州）科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）和《关于芯慧联新（苏州）科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）。本次增资事项包括芯傲华在内共计9名投资人拟与芯慧联新员工持股平台以现金方式对芯慧联新增资，增资合计人民币23,362万元，其中芯傲华拟增资人民币1亿元，增资后芯傲华持有芯慧联新10.4822%股权。

二、标的公司基本信息

公司名称：芯慧联新（苏州）科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：刘红军

成立日期：2024 年 9 月 12 日

统一社会信用代码：91320581MAE051LP05

地址：常熟市高新技术产业开发区金门路 2 号 2 幢

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件制造；电力电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；半导体照明器件制造；3D 打印服务；集成电路设计；3D 打印基础材料销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；电力电子元器件销售；科技中介服务；技术进出口；货物进出口；物联网技术服务；软件开发；半导体照明器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、本次交易进展情况

上述《增资协议》和《股东协议》已于 2025 年 1 月 26 日完成签署，本次签署的协议内容与此前披露的协议内容一致。

四、其他事项说明

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日